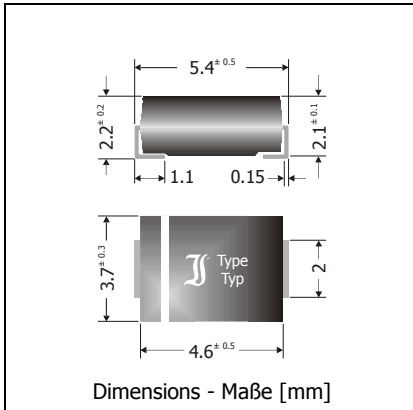


SK32SMB ... SK310SMB
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2012-01-03



Nominal current – Nennstrom

3 A

Repetitive peak reverse voltage

20...100 V

Periodische Spitzensperrspannung

Plastic case

~ SMB

Kunststoffgehäuse

~ DO-214AA

Weight approx. – Gewicht ca.

0.1 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle


Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾
SK32SMB	20	20	< 0.55
SK33SMB	30	30	< 0.55
SK34SMB	40	40	< 0.55
SK35SMB	50	50	< 0.70
SK36SMB	60	60	< 0.70
SK38SMB	80	80	< 0.85
SK310SMB	100	100	< 0.85

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

SK32..SK36SMB I_{FAV} 5 A ²⁾SK38, SK310SMB I_{FAV} 5 A ³⁾

Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom

 $f > 15$ Hz I_{FRM} 20 A ²⁾

Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 80/90 A

Rating for fusing, $t < 10$ ms
Grenzlastintegral, $t < 10$ ms

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 32 A²s

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur

 T_j -50...+150°C

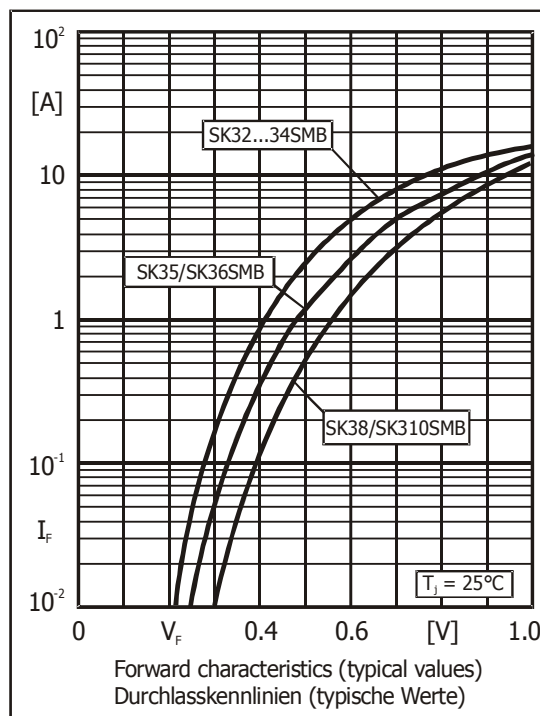
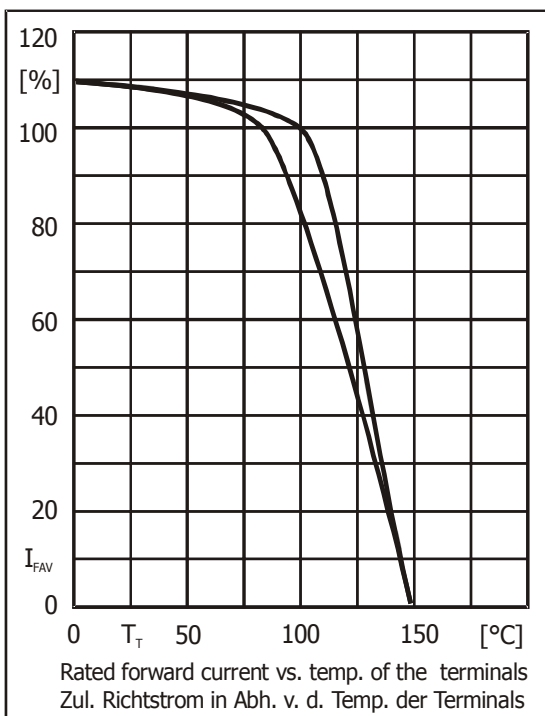
Storage temperature – Lagerungstemperatur

 T_s -50...+150°C1 $I_F = 3$ A, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 2 Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$ 3 Max. temperature of the terminals $T_T = 85^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 85^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Leakage current	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 200 μA
Sperrstrom	$T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 mA
Thermal resistance junction to ambient air			R_{thA}	< 70 K/W ¹⁾
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft				
Thermal resistance junction to terminal			R_{thT}	< 30 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss				



1 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss